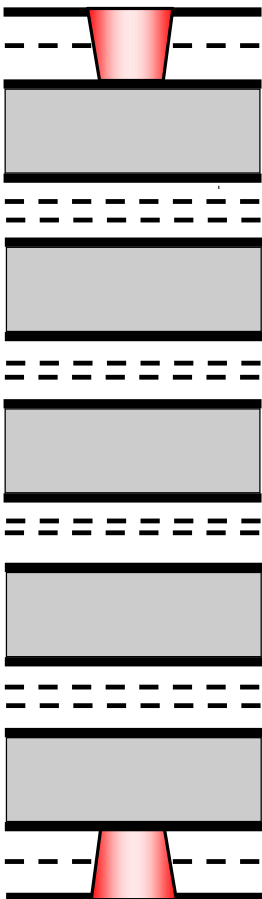


LAGENBEZEICHNUNG		AUFBAU	BASIS-Material	CU	PREPREG ANZAHL/TYP	ENDDICKE	KUNDEN-FORDERUNG	
KUNDE	WE					[μm]	[μm]	
1	TOP/VS			Folie	12 μm	1)	12	
2	2				17,5 μm	1 x 1080	66	
3	3			0,100 mm			100	
4	4				17,5 μm		16	
5	5					2 x 1080	134	
6	6				17,5 μm		16	
7	7			0,100 mm			100	
8	8				17,5 μm		16	
9	9					2 x 1080	134	
10	10				17,5 μm		16	
11	11			0,100 mm			100	
12	BOT/RS			17,5 μm		16		
			Folie	12 μm	1)	12		
1) Kupferenddicke Außenlagen ca. 55 μm								
Gesamtdicke Material:						1352		
<small>Anmerkung: Werte für Prepreg sind Mittelwerte (der genaue Wert ist von den Leiterbildstrukturen abhängig)</small>								

MATERIALDICKE:		1,35	+-	0,11	mm	Datum:		Bearbeiter:	
DICKE über galv. Endoberfläche		1,44	+-	0,14	mm				
DICKE über LSM incl.galv.-Kupfer		1,50	+-	0,16	mm				
Kundenforderung:			+-		mm	Messstelle:			
Erstellt am	von	Geprüft am	von	Freigegeben am	von	Revision			
28.03.2006	S. Keller	04.05.2006	M.Kress	04.05.2006	R. Schönholz	00		Seite: 4+	